

**Toshiba kündigt neue Kamera- und Display-Bridge-Chips für mobile Geräte an**

*Bridge-Chips bieten bis zu 800 Mbit/s Datenübertragungsrate für hochauflösende Displays und Kameras*

**Mobile World Congress, 15. Februar 2010** – [Toshiba Electronics Europe](#) kündigt drei neue Bridge-Chips für Mobiltelefone an: einen MIPI®-CSI-zu-MDDI®-Chip (Mobile Industry Processor Interface – Camera Serial Interface zu Mobile Display Digital Interface) (TC358740XBG) und zwei MDDI-MIPI Display Serial Interface (DSI) Chips (TC358760XBG und TC358761XBG). Die Bausteine stellen eine schnelle serielle Schnittstelle zwischen dem Basisband- oder Applikationsprozessor eines Mobiltelefons und dem Display oder der integrierten Kamera des Telefons dar. Sie sind heute eine Voraussetzung für hochauflösende Displays und Kameras in Smartphones, mobilen Internet-Geräten, Netbooks, Smartbooks und anderen hochleistungsfähigen mobilen Endgeräten. Die Bausteine erweitern Toshibas Angebot an Embedded Mobile Peripheral SoCs.

Smartphones und andere mobile Geräte bieten immer mehr Funktionen wie HD-Video, 3-D-Grafik, hochauflösende Bild- und Filmaufnahmen und sogar Videokonferenzdienste. Die neuen Bridge-Chips unterstützen schnelle MIPI- und MDDI-Schnittstellen und ermöglichen die Entwicklung von Mobiltelefonen, die zwischen Display, Kamera und Basisband- oder Applikationsprozessor eine Datenkommunikation mit hoher Bandbreite garantieren. Der Anwender profitiert damit von einer bisher unerreichten Videoqualität.

Der Kamera-Bridge-Chip TC358740XBG stellt die Anbindung für MIPI-Kameras zum Basisband- oder Applikationsprozessor über eine MDDI-Schnittstelle her. Der Baustein unterstützt MDDI 1.2 Typ 2 auf der Host-Seite und bietet Support für bis zu zwei Kameras, wobei die Hauptkamera einen MIPI-Link und die zweite Kamera einen MIPI-Link oder Parallelanschluss nutzt. Der Bridge-Chip ermöglicht schnelle serielle Schnittstellen auf der Host- (über MDDI) und auf der Kameraseite (über MIPI CSI-2), womit in einem Mobiltelefon eine Hauptkamera mit bis zu 12 MPixel und eine zweite Kamera mit bis zu 2 MPixel unterstützt werden. Der Baustein ist kompatibel zu Systemen, die mit MDDI-fähigen Basisband-Prozessoren von ausgestattet sind.

Die Display-Bridge-Bausteine TC358760XBG und TC358761XBG wurden für Mobiltelefone optimiert, die eine schnelle serielle Digital-Packet-MDDI-Host-Schnittstelle verwenden. Die Bridge-Chips stellen die Verbindung von MIPI-Display-Panels zum Basisband- oder Applikationsprozessor über die MDDI-Schnittstelle her. Sie basieren auf MDDI 1.2 Typ 1 und MIPI DSI 1.01 Interfaces, sind aber rückwärtskompatibel zu MDDI 1.1 und unterstützen direkte Bildauffrischung über die MDDI-Verbindung. Der TC358761XBG unterstützt auch herkömmliche Parallelschnittstellen wie MIPI DPI und MIPI DBI auf der Host- oder der Panelseite. Damit lassen sich bestehende Designs oder Komponenten erneut verwenden oder auch aufwerten. Die Bausteine sind kompatibel zu Systemen, die mit MDDI-fähigen Basisband-Prozessoren von ausgestattet sind.

**Verfügbarkeit**

Entwicklungsmuster des Display-Bridge-Chips TC358761XBG und des Kamera-Bridge-Chips TC358740XBG sind ab sofort erhältlich. Entwicklungsmuster für den Display-Bridge-Chip TC358760XBG stehen ab April 2010 zur Verfügung. Die Volumenfertigung für den TC358740XBG beginnt im 3. Quartal 2010; für den TC358760XBG und TC358761XBG im 4. Quartal 2010.

###

MIPI ist eine Schutzmarke der MIPI Alliance Inc. in den USA und in anderen Ländern. MDDI ist eine eingetragene Marke der Video Electronics Standards Association (VESA).

### Zu Toshiba

Toshiba Electronics Europe (TEE) ist die europäische Niederlassung der Toshiba Corporation, einem der weltweit größten Halbleiterhersteller, die das Geschäft mit elektronischen Bauelementen verantwortet. TEE bietet eine der branchenweit umfangreichsten Produktlinien im Bereich ICs und diskrete Bauelemente, einschließlich Speicher, Mikrocontroller, ASICs, ASSPs und Displays für die Märkte Automotive, Multimedia, Industrie, Telekommunikation und Netzwerktechnik. Das Unternehmen bietet darüber hinaus auch eine Vielzahl von Leistungshalbleitern. TEE wurde 1973 in Neuss gegründet und stellt heute Design-, Fertigungs-, Marketing- und Vertriebsaktivitäten über seine Zentrale in Düsseldorf zur Verfügung. Weitere Niederlassungen finden sich in England, Frankreich, Italien, Schweden und Spanien. TEE beschäftigt in Europa ca. 300 Mitarbeiter. Präsident des Unternehmens ist Mr. Hitoshi Otsuka.

Die Toshiba Corporation zählt zu den weltführenden innovativen Anbietern von Hochtechnologie, Fertigungs- und Vertriebsaktivitäten rund um fortschrittliche Elektronik und Elektrotechnik. Dabei werden die Märkte Informations- und Kommunikationstechnik; digitale Unterhaltungselektronik; Elektronikgeräte und Elektronikbauteile; Stromversorgungssysteme, einschließlich Atomenergie; industrielle und soziale Infrastrukturnetzwerke sowie Haushaltsgeräte bedient. Toshiba wurde 1875 gegründet, betreibt heute ein weltweites Netzwerk mit über 740 Unternehmen und zählt an die 199.000 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz des Unternehmens beträgt über \$73 Mrd. US-\$.

Weitere Informationen über Toshiba Electronics Europe unter: [www.toshiba-components.com](http://www.toshiba-components.com)

### Ansprechpartner für Veröffentlichungen:

Toshiba Electronics Europe, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland  
Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79 197  
Web: <http://www.toshiba-components.com/pressoffice/index.asp>  
E-mail: ASIC/SOC: [customsoc-internet@toshiba-components.com](mailto:customsoc-internet@toshiba-components.com)

### Ansprechpartner für die Presse:

Henning Rausch, Toshiba Electronics Europe  
Tel: +49 (211) 5296 117  
E-mail: [HRausch@tee.toshiba.de](mailto:HRausch@tee.toshiba.de)

### Herausgegeben durch:

Simon Flatt oder Andrew Town, Pinnacle Marketing Communications Ltd.  
Prosperity House, Dawlish Drive, Pinner, Middlesex, HA5 5LN, England  
Telefon: +44 (0) 20 8869 9229/+44 (0) 20 8429 6546 Fax: +44 (0) 20 8868 4373  
E-Mail: [simon@pinnaclemarcom.com](mailto:simon@pinnaclemarcom.com) oder [andrew@pinnaclemarcom.com](mailto:andrew@pinnaclemarcom.com)  
Web: [www.pinnacle-marketing.com](http://www.pinnacle-marketing.com)

Februar 2010

Ref: 5997/A